

～ MECのこれまでとこれから ～

開催日時： 2026年3月28日（土曜日）

出席者：	メ	ツ	ク	代表取締役社長	前田	和夫
	メ	ツ	ク	取締役 常務執行役員	谷口	哲也
	メ	ツ	ク	執行役員 CFO 経理財務本部長	北氏	克明
	メ	ツ	ク	コーポレートコミュニケーション室室長	松下	綾

会社概要

2025年12月期は売上高が連結で209億円となりました。従業員は、日本に約300人、連結で500人以上となります。拠点は、兵庫県に本社、研究所、工場（少量多品種）、そして新潟県長岡市に量産工場を持っております。子会社は台湾、中国に2カ所、タイ、ベルギー、インドにございます。

株主構成

株主構成は、外国人が増えて、金融機関が少し減ったという状況でございます。

成長の軌跡

売上高は、リーマンショック、新型コロナウイルス感染症の世界的流行、ITバブル崩壊、震災等々あった中、ゆっくりではありますが、右肩上がりに成長しております。2025年12月期は、AIが勃興し進展が進む状況で、当社の製品需要もAI関係で直接・間接的に増加しました。

理念体系図

一番上が経営理念。Missionは「界面から、世界を変える」を掲げております。「界面」というのは境界面です。物と物、物質と物質の境界面、こちらに当社の化学薬品を使用する。例えば金属と樹脂とを接合させる場合に、金属の表面に当社薬品で処理をして価値を持たせる。そうした技術が半導体パッケージ基板や、それを搭載した機器に使用され、きちんと動くようにというような役割を果たしております。当社はそういった目立たないところに使用される技術を提供しており、小さいところ、あるいは目立たないところ、そこから世界を変えようということを考えて仕事をしております。

コア技術

界面を改質するというのが当社のコア技術です。密着を向上させる技術、細かい配線をきれいに形成する技術、選択的にエッチングする技術がございます。密着を向上させる技術には、当社の代表製品である CZ がございます。これは銅の表面を細かく粗化することで樹脂を食い込ませアンカー効果により密着力を向上させる当社の代表的な技術です。また、化学的に密着性を向上させる技術も保有しており、非常に薄い分子レベルに近いような被膜を金属の表面に付けることで樹脂との密着性が向上するという技術です。

当社の強み

当社の強みは、粗化技術を中心に、特に半導体を搭載するための半導体パッケージ基板向けで高いシェアを持つ薬品を保有している点です。付加価値が高く、最近では AI 半導体の活況な需要を受け伸びております。また、AI 関係以外でも一般サーバー向けやパソコン、スマートフォン向けの半導体パッケージ基板の製造にも当社製品が使用されております。今後は AI に関わる通信速度上昇に伴い技術の変化点を迎えると見ている高多層基板に注目しております。高速通信により高付加価値化することで市場が拡大すると見通しており、当社もしっかりとその中に入り込んでシェアを獲得していきたいと考えております。

独自の技術力により世界独占的シェアを確立

当社はニッチな領域で、世界的に独占的シェアを獲得している CZ シリーズを保有しております。CZ シリーズは半導体パッケージ基板を作る工程に使用されております。お客様は 300 社以上あり、最終製品はアメリカのハイテク企業等に納められております。CZ シリーズを発売してから 30 年以上経ちますが、CZ に起因する市場クレームはほぼゼロという実績があります。そのため、信頼性高くお客さまに使用いただいております。製品は継続的に改良を実施しております。

半導体パッケージ基板（PKG）

半導体パッケージ基板の断面図をお見せしております。黒く見えている部分が樹脂で、白く見えている部分が銅配線。電子機器は主にマザーボードの上に半導体パッケージ基板が載り、さらにその上に半導体載るといった構造になっております。

当社 CZ の使用量は半導体パッケージ基板の個数、面積、層数の増加に伴い多くなります。最近の半導体パッケージ基板は特に AI 向けを中心に大型化・多層化が進んでおりますので、単に個数が増えるというだけではなく、半導体パッケージ基板の大型化・多層化、という点で使用量が増える状況にあります。

CZシリーズの役割

CZの役割は、異なる膨張係数を持つ銅と樹脂をくっつけ、剥がれを防ぐということです。剥がれてしまいますと電子機器が動かなくなるということで、ここの信頼性は、地味ですがけれども非常に大きい役割を果たしていると言えらると思ひます。

活躍できる分野

当社製品が使用され製造された電子基板は様々なタイプがあります。皆さんの身の回りにある電子機器の多くに当社製品が使用された部品が必ず入っております。国内だけでなく、世界中で使用いただいております。

2025年12月期 総括

業績については、当社が関係する市場はおおむね堅調に推移しました。データセンター、生成AI関連が市場の成長を牽引し、売上高と営業利益は過去最高を更新しました。

売上構成

売上構成は、ほとんどが薬品売上、そのうちCZシリーズの売上が全体の3分の2程度ございます。地域別売上では日本が37.4%、この中には韓国向けも含まれております。中国2カ所と台湾の売上が大きく顧客も多いです。直近では、タイの売上が大きくなってきており今後も伸び続けると見ております。

株主還元

株主還元は、方針をはっきりさせました。連結配当性向35%以上、かつ、連結株主資本配当率（DOE）が4.0%以上にて還元をおこなっていくということといたします。従って2025年12月期の配当金は年間で1株当たり96円になっております。自己株式取得は適宜実施しており、直近では昨年7月に50万株の自己株式取得、償却をしております。

株主優待

株主優待制度を見直し、長期に持っていただきたいという思いをここに込めております。

2026年12月期 連結業績予想

2026年12月期の業績予想は、売上225億円、営業利益65億円、純利益46億円を目指して参ります。純利益が2025年より減少する原因は、2025年の純利益が非常に高い水準だったことが影響しております。具体的には、2025年に発生した北九州工場に関する補助金取得があったことや2024年に閉鎖した香港子会社に関わる税制優遇があり、2025年の純利益が高くなっております。

北九州工場（仮称）

北九州工場は、日本工場の BCP の観点、新潟県の長岡工場で対応している大量生産をバックアップする目的で建設中でございます。2026 年 12 月に稼働予定で、予定どおりに進んでおります。

2030 年ビジョン Phase 2 中期経営計画

サマリー

初年度の 2025 年 12 月期の業績が、当初想定を上回ったことを踏まえて、Phase2 最終年度である 2027 年 12 月期の目標を修正しております。戦略を見直したのではありません。コア事業を当初計画から少し上方修正し、遅延が見えている応用展開は少し下方修正しております。また、営業利益率は 26~30%へ、ROE は 13~16%へ修正しております。なお、株主還元につきましては配当方針を連結配当性向 35%以上、かつ、DOE4.0%以上に変更しております。

事業領域の拡大を目指して

様々なコア技術の深堀り、水平展開を中心に進めております。これからも当社のコア技術を活かせる市場で技術の水平展開や応用展開、既存技術から少し離れたところの事業の創出等も目指し頑張っております。

■ 質疑応答 ■

質問：2026 年 12 月期の業績予想の前提条件について

前田：売上は、2025 年度に比べ機械売上が減少し、薬品売上が大きく増加すると想定しております。生成 AI 関連が好調に推移し、メモリーは生成 AI 関連が優先され増産が実現するまで需要がひっ迫すると見ております。

質問：研究開発費について

前田：研究開発にはますます力を入れたい。連結売上高の約 10%を目標に置き、しっかり人員増強や研究開発施設の拡張・充実を進め収益につなげていくということに取り組んでいきたいと考えております。

質問：原油価格の影響について

前田：様々なタイプの原材料を、個別に精査しております。基本的には当社の原材料は、原油由来のものは少ないですが、原油はいろいろなものの原材料になっておりますので、当社のみならず、例えば電子基板業界の関係各社、樹脂材料等、原油由来も多くの異なる影響が顕在化してくるであろうと考えており、当社ができることとして、個別での原材料調達・入手を精査しているという状況でございます。

質問：北九州工場について

前田：お客さまの承認に関しましては状況によりますが、半年、1年ぐらいかかる場所もあるかもしれないというところがございます。

質問：AI 向けのメモリー容量を削減するという新技術について

前田：メモリー効率の向上により一時的に物量はその一部の領域について減るということはある得ると考えておりますが、ただ、それは恐らく大きな全体の中の一部であろうと考えられます。今回のこの件については非常に興味を持って見ておりますが、これが何か脅威になるとは感じておりません。

質問：為替について

北氏：当社は、子会社が台湾、中国、ベルギー、タイにあり現地の通貨を使っております。為替の影響は、日本が販売するものにつきましては円建てが多く、子会社が販売するものは外貨になります。為替の感応度は、昨年の実績で、例えば過去の為替がドルと連動して動いたと仮定した場合、1ドル1円上がる、円安になった場合、売上高で約8,900万円増加、営業利益では5,400万円増加の影響がございました。

質問：CZ の競合について

谷口：CZ についてはトップレベルの信頼性を武器とし、競合はほぼいない認識です。

質問：化学密着技術が粗化技術にとって代わるかどうかについて

谷口：現時点では技術の変化はきておりませんが、将来的には一部の領域において置き換わっていくと考えております。置き換わる一部の領域というのは、ものすごく高周波・信号の伝達スピードが速い、という技術が求められる領域のみで、すべての領域が化学密着技術に置き換わるということはないだろうと思っております。

質問：個人投資家向けの展示会について

松下：個人の投資家さまに当社の魅力を伝える場というのは非常に重要だと考えており、今年も前向きに検討している状況です。出展の内容は、当社の技術がどこにどのように使われているのかということを理解していただけるような展示内容を考えております。

質問：知財について

前田：基本的に特許で知財を守るという考え方で対応しております。

以上